
2004年4月28日



2004年3月期
決算説明会

東京エレクトロン デバイス株式会社



TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED

2004年3月期 業績

(単位:百万円)

	2003年3月期		2004年3月期		増減率 %
		百分比%		百分比%	
売上高	78,811	100.0	85,738	100.0	8.8
売上総利益	10,388	13.2	11,377	13.3	9.5
営業利益	2,998	3.8	3,182	3.7	6.1
経常利益	2,574	3.3	2,952	3.4	14.7
当期純利益	1,423	1.8	1,680	2.0	18.0
1株当たり当期純利益	84,950.33円		35,991.94円		
R O E	15.7%		13.8%		
1株当たり年間配当金	13,000円		13,300円		
従業員数	531人		534人		



2004年3月期 資産

(単位:百万円)

科目	2003年3月期	2004年3月期	増減額
現預金	483	638	155
受取手形・売掛金	19,889	20,441	551
たな卸資産	11,004	12,555	1,550
その他流動資産	685	867	182
有形固定資産	326	346	19
無形固定資産	568	368	199
投資その他の資産	2,083	2,206	123
資産計	35,041	37,424	2,382

2004年3月期 負債・資本

(単位:百万円)

科目	2003年3月期	2004年3月期	増減額
買掛金	5,948	7,612	1,663
短期借入金	4,500	3,000	1,500
その他流動負債	2,384	2,956	572
長期借入金	8,000	8,000	-
その他固定負債	2,604	3,080	475
負債計	23,437	24,649	1,211
資本金	2,495	2,495	-
資本剰余金	2,054	2,054	-
利益剰余金	7,053	8,224	1,171
資本計	11,603	12,775	1,171
負債・資本計	35,041	37,424	2,382

2004年3月期 キャッシュ・フロー

(単位:百万円)

	2003年3月期	2004年3月期	増 減
営業キャッシュ・フロー	2,086	2,399	313
投資キャッシュ・フロー	274	243	31
財務キャッシュ・フロー	1,606	1,998	392
換算差額	9	1	10
現金等の増減額	214	155	58

2004年3月期 品目別売上高

(単位:百万円)

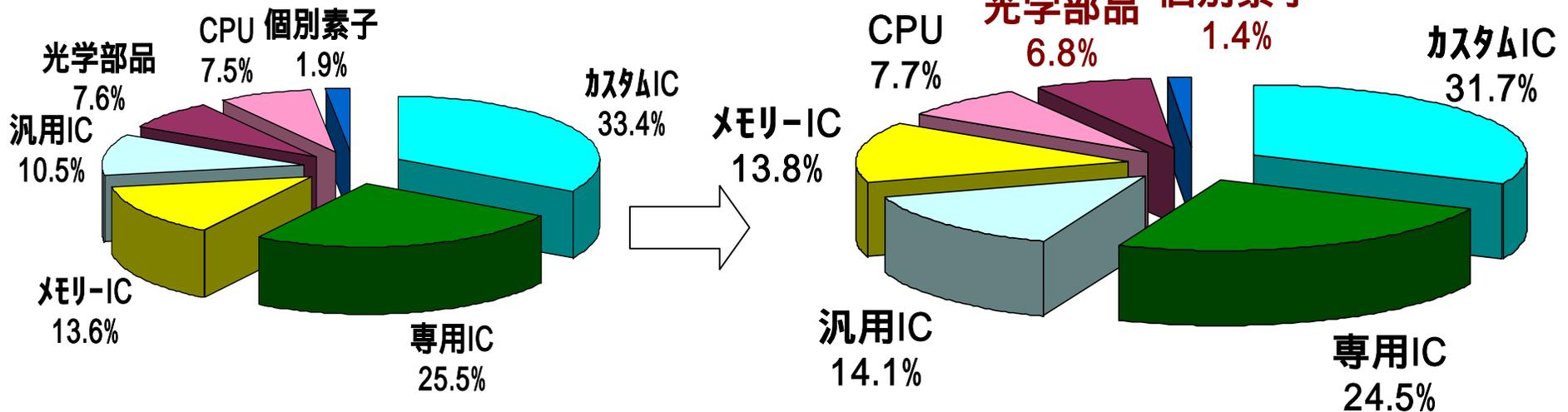
品目*	2003年3月期		2004年3月期		増減率 (%)
	売上高	構成比%	売上高	構成比%	
半導体製品	69,552	88.2	75,468	88.0	8.5
ボード製品	3,432	4.4	4,325	5.1	26.0
ソフトウェア	2,548	3.2	2,998	3.5	17.7
一般電子部品	3,277	4.2	2,944	3.4	10.2
合計	78,811	100.0	85,738	100.0	8.8

* 各品目についての説明は、P.35 P.36をご参照ください。

2004年3月期 半導体製品売上構成比

< 2003年3月期 >

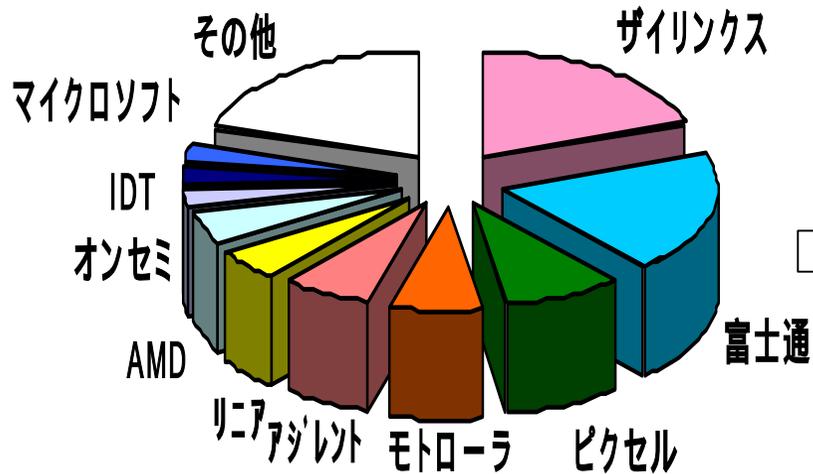
< 2004年3月期 >



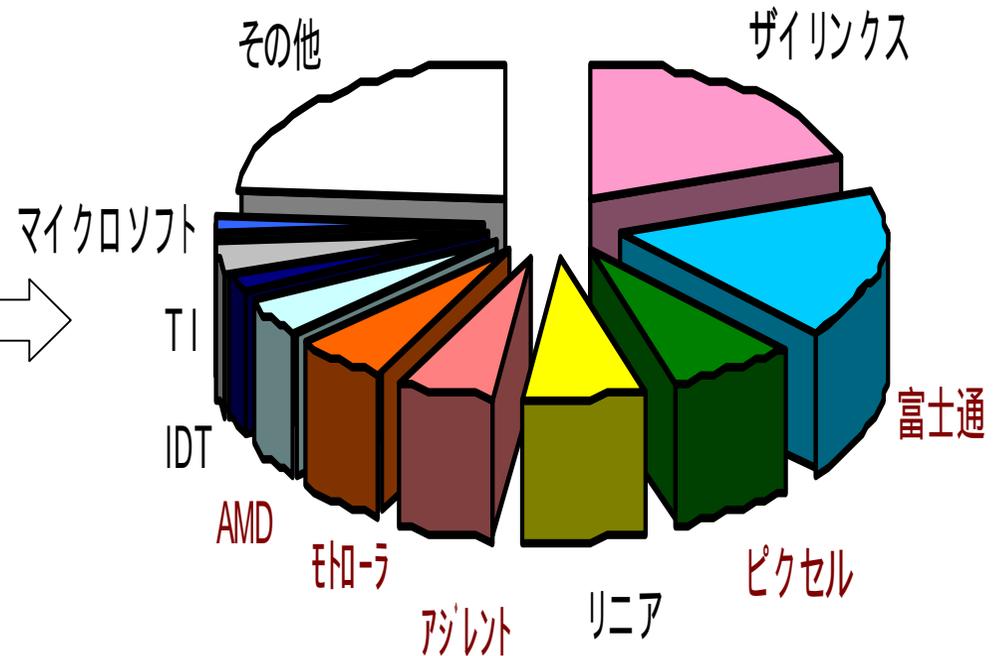
* 品目についての説明は、P.35をご参照ください。

2004年3月期 商品別売上構成比

< 2003年3月期 >



< 2004年3月期 >



注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

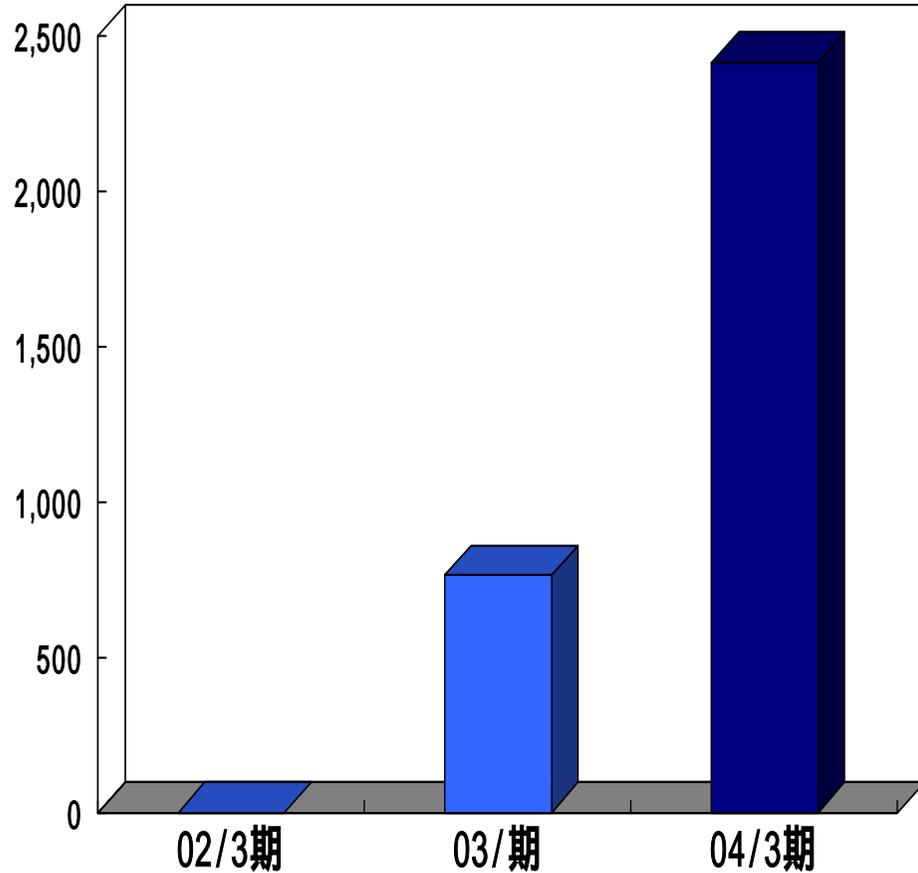
2004年3月期 主要商品別売上増減要因

仕入先名	増減率	要 因
ザイリンクス社	7%	民生機器への用途拡大
富士通(株)	0.1%	民生機器、複合機を中心に販売
ピクセルワークス社	2%	生産地 海外移管により減少
リニアテクノロジー社	60%	販権拡大
アジレント・テクノロジー社	5%	携帯電話端末向け減少
モトローラ社	0.6%	通信設備投資低迷
開発ビジネス	33%	設計受託案件増加

新規商品 売上高

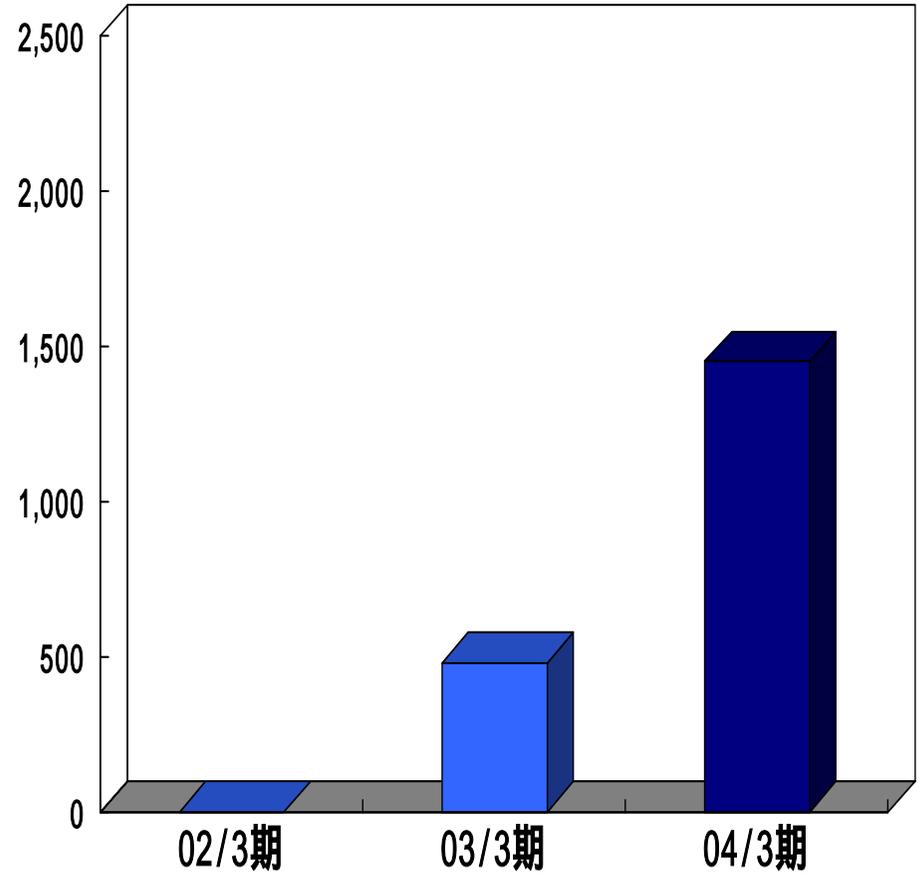
テキサス・インスツルメンツ(TI)社

(百万円)



インフィオン社

(百万円)



仕入先数

(単位:社)

	2003年3月期	2004年3月期	増	減
国内	8	9	1	-
海外	37	35	2	4
計	45	44	3	4

< 2004年3月期 新規契約先 >

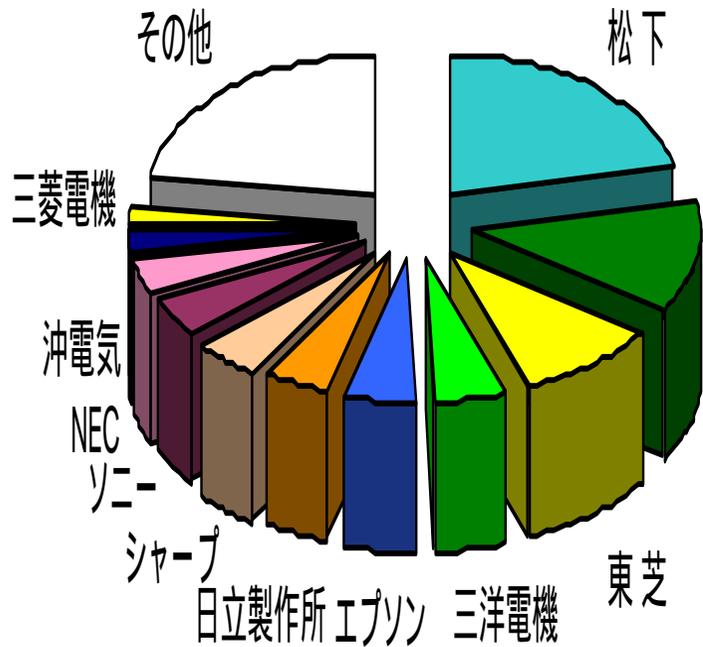
- ・ (株)PFU(日本)
組み込み向けボード
- ・ シロン インテグレートッド システムズ 社(台湾)
家庭用端末制御 IC
- ・ ホテンシア セミコンダクター 社(カナダ)
電源制御 IC

< 今後 契約予定 >

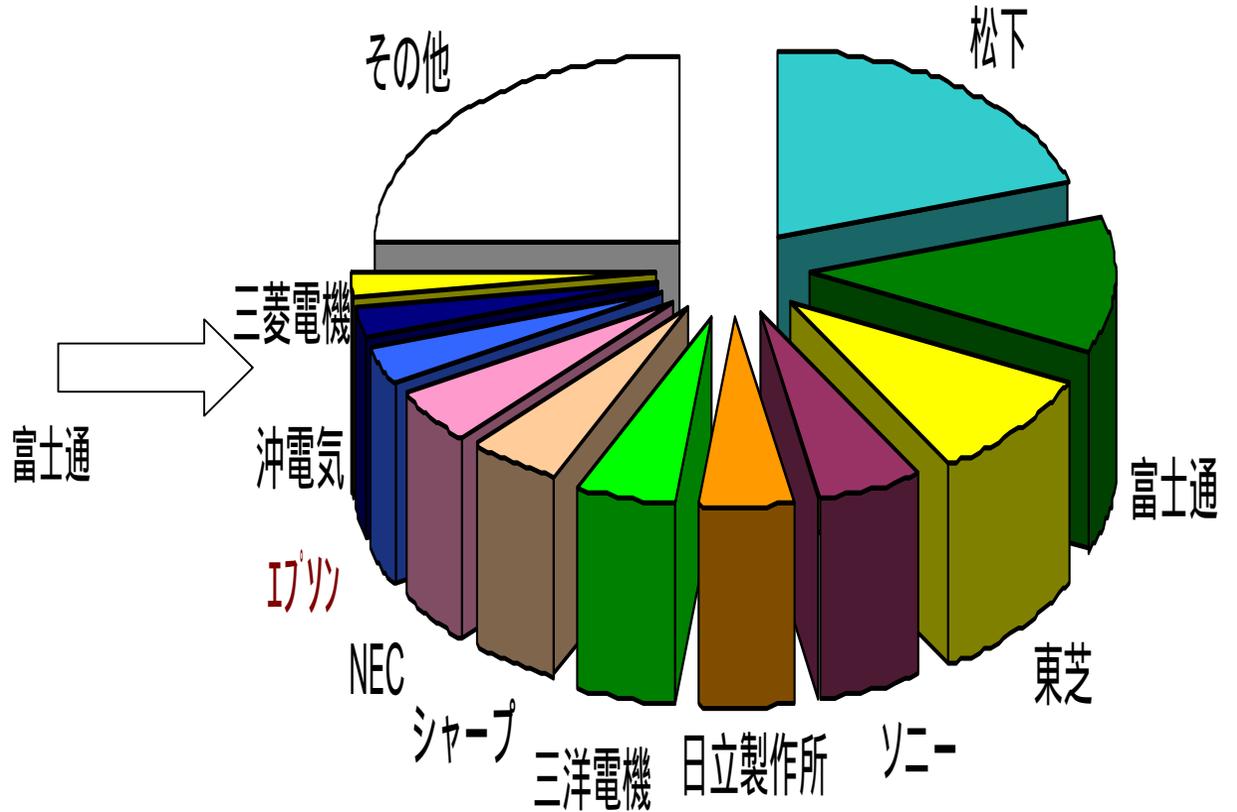
国内: 1社
海外: 3社

2004年3月期 顧客別売上構成比

< 2003年3月期 >



< 2004年3月期 >

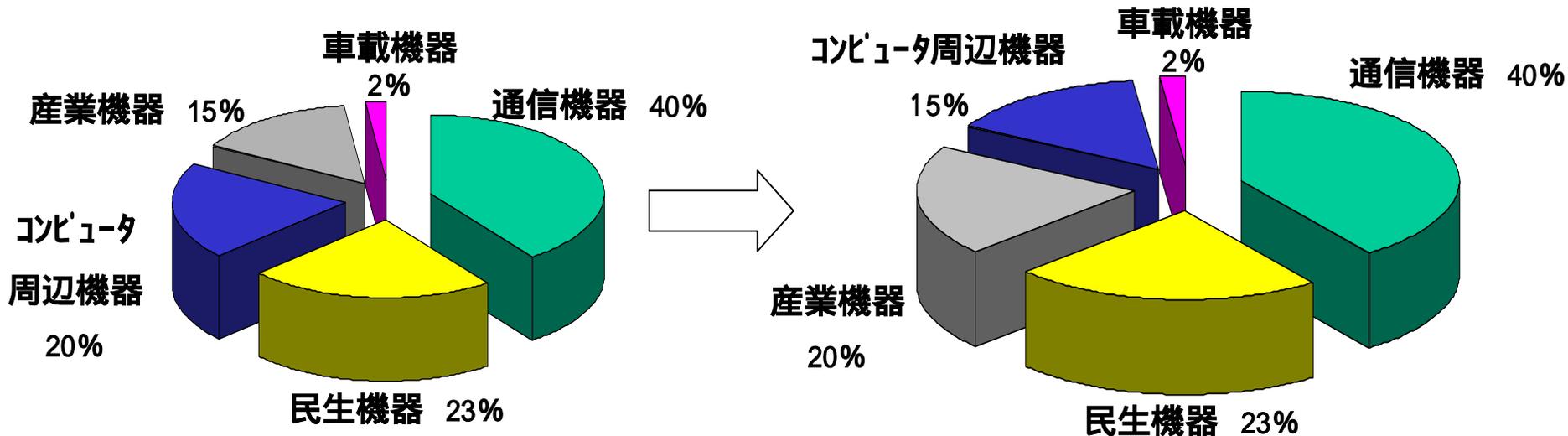


注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

2004年3月期 用途別売上構成比

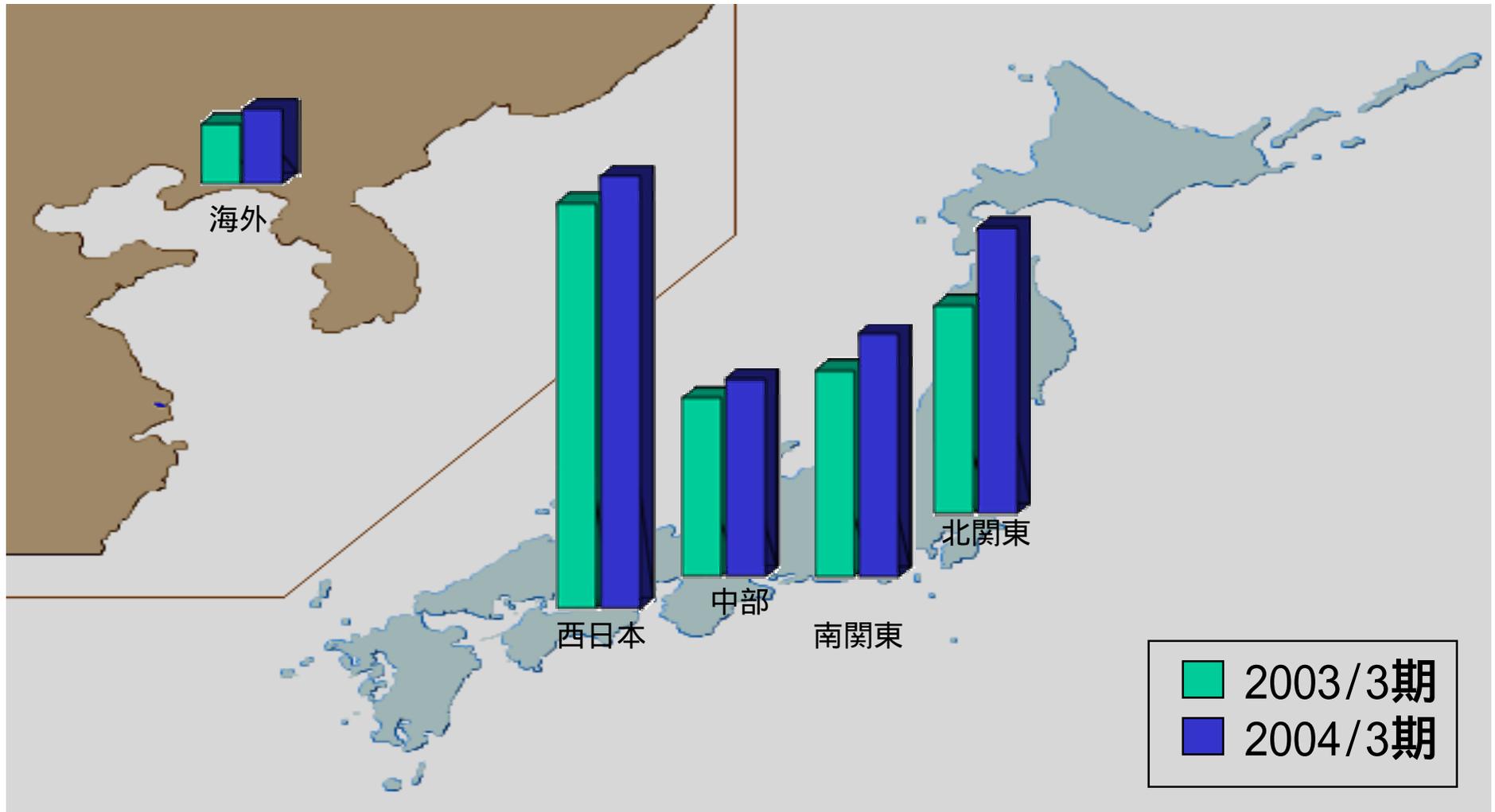
< 2003年3月期 >

< 2004年3月期 >



用途	主なアプリケーション
通信機器	ターミナルアダプタ、ケーブルモデム、携帯電話、ルーター、交換機、基地局
民生機器	デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、チューナー、液晶TV、プラズマTV、DVD
産業機器	セキュリティ監視機器、医療機器、放送機器、テスター、半導体製造装置
コンピュータ周辺機器	プリンター、プロジェクター、POS、PC、ワークステーション、汎用コンピュータ
車載機器	カーナビゲーション、カーオーディオ

営業拠点別 売上構成



2004年3月期 トピックス

- ・報酬委員会、指名委員会 設置(7月)
- ・長岡/岡山サテライトオフィス 開設(10月)
- ・株式分割 実施(11月)
- ・厚生年金基金代行返上認可(1月)
- ・東京エレクトロン デバイス上海 設立(1月)

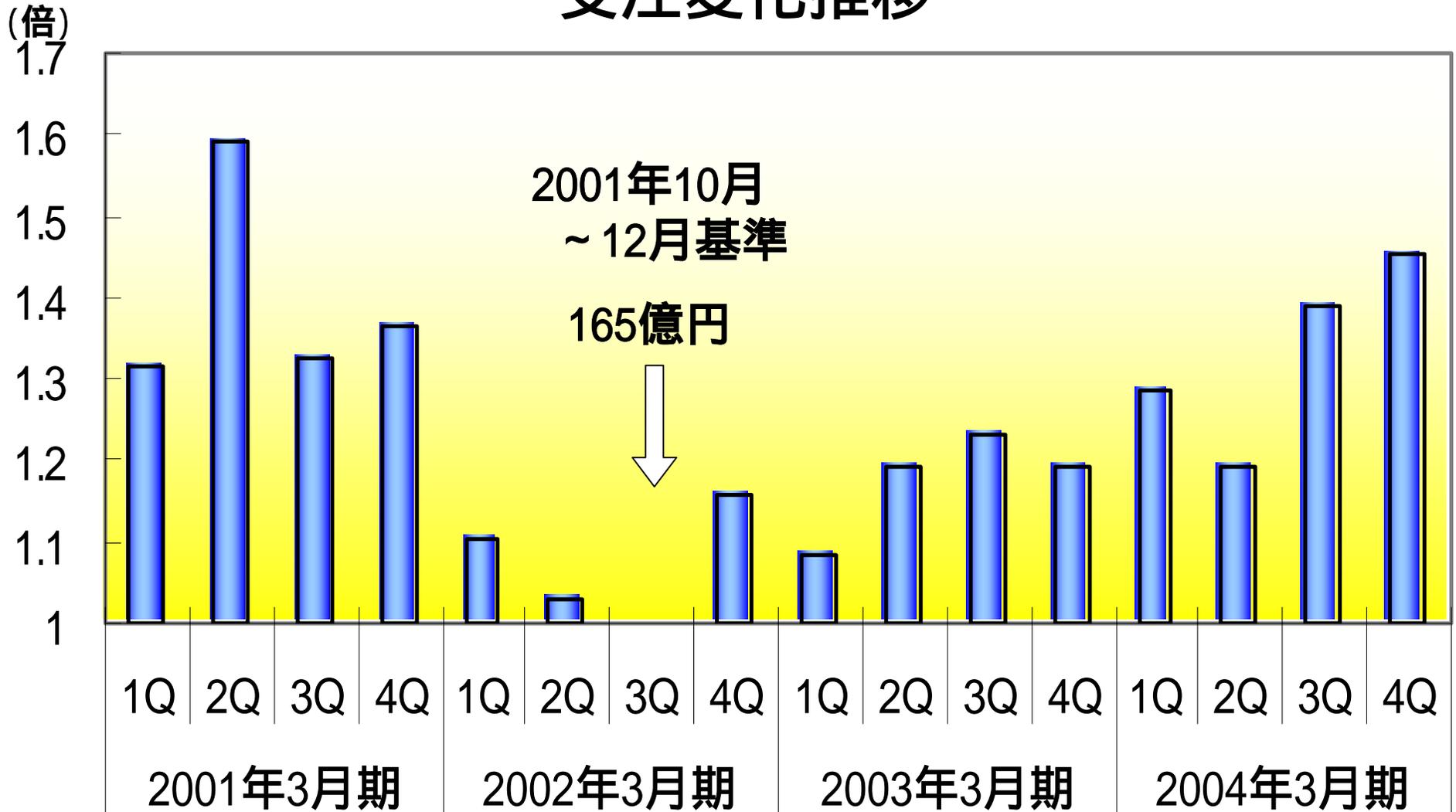
今期予定 トピックス

- ・京都サテライトオフィス 開設(4月)
- ・香港駐在員事務所 開設(6月予定)

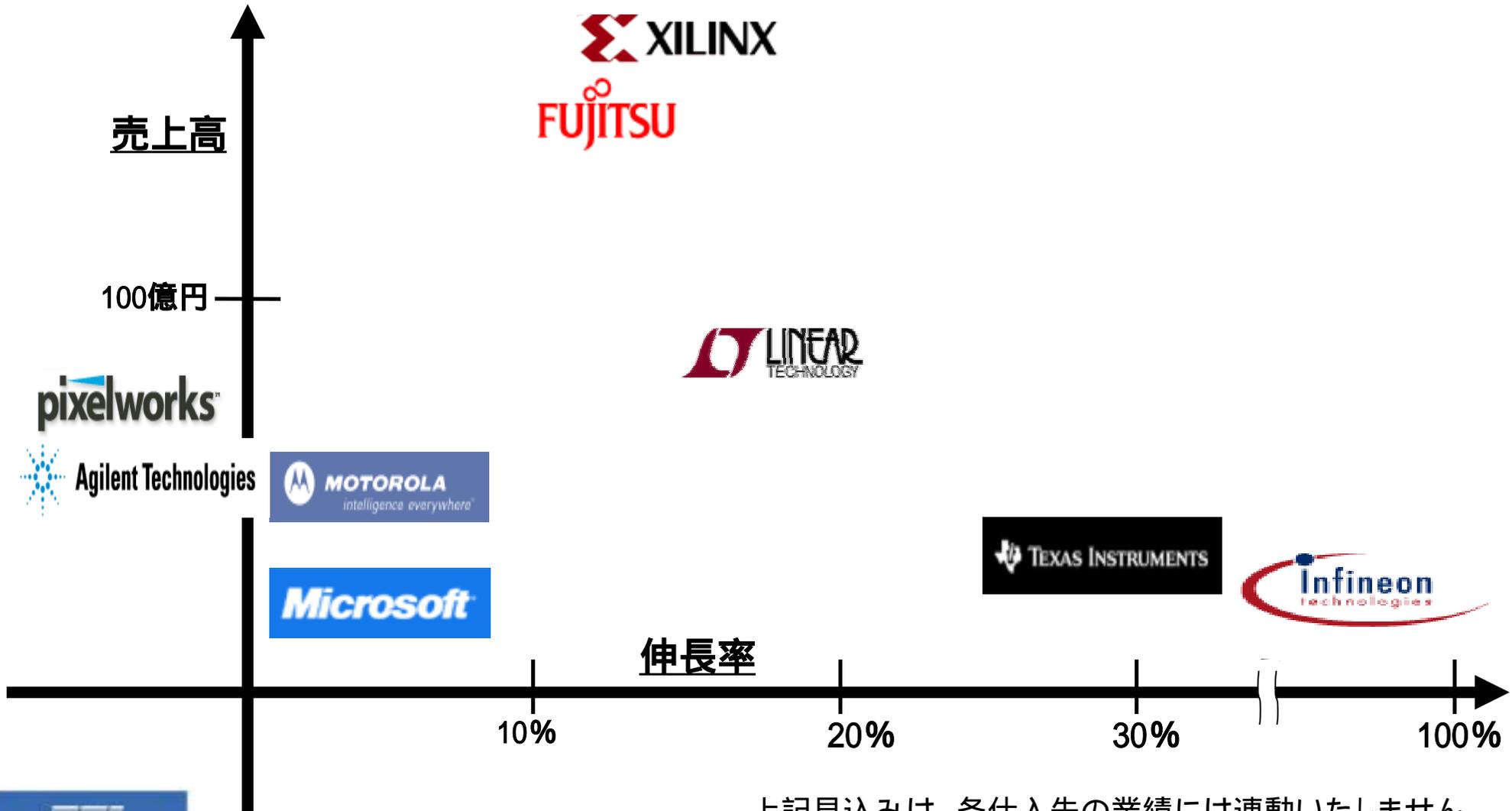
今期の業績予想について



受注变化推移



主要仕入先別 売上分布予想



上記見込みは、各仕入先の業績には連動いたしません。

用途別 事業環境予想

用途	アプリケーション	主な仕入先	傾向
通信機器	基幹系通信インフラ	ザイリンクス社、モトローラ社	→
	携帯電話端末	リアテクノロジー社、インフィニオン社	↗
民生機器	液晶TV・プラズマTV	富士通(株)、ザイリンクス社	↗
	DVD	ユーティナデバイス(株)(旧 富士通カクタムデバイス(株))	→
産業機器	テスター	TI社、ザイリンクス社、モトローラ社	↗
	FA機器	TI社、マイクロソフト社、アジレント・テクノロジー社	↗
コンピュータ及び 周辺機器	PC・周辺機器	リアテクノロジー社	→
	プロジェクター	ピクセルワークス社	→
車載機器	カーナビゲーション	富士通(株)	↗

上記見込みは、各仕入先の業績には連動いたしません。

2005年3月期 業績予想

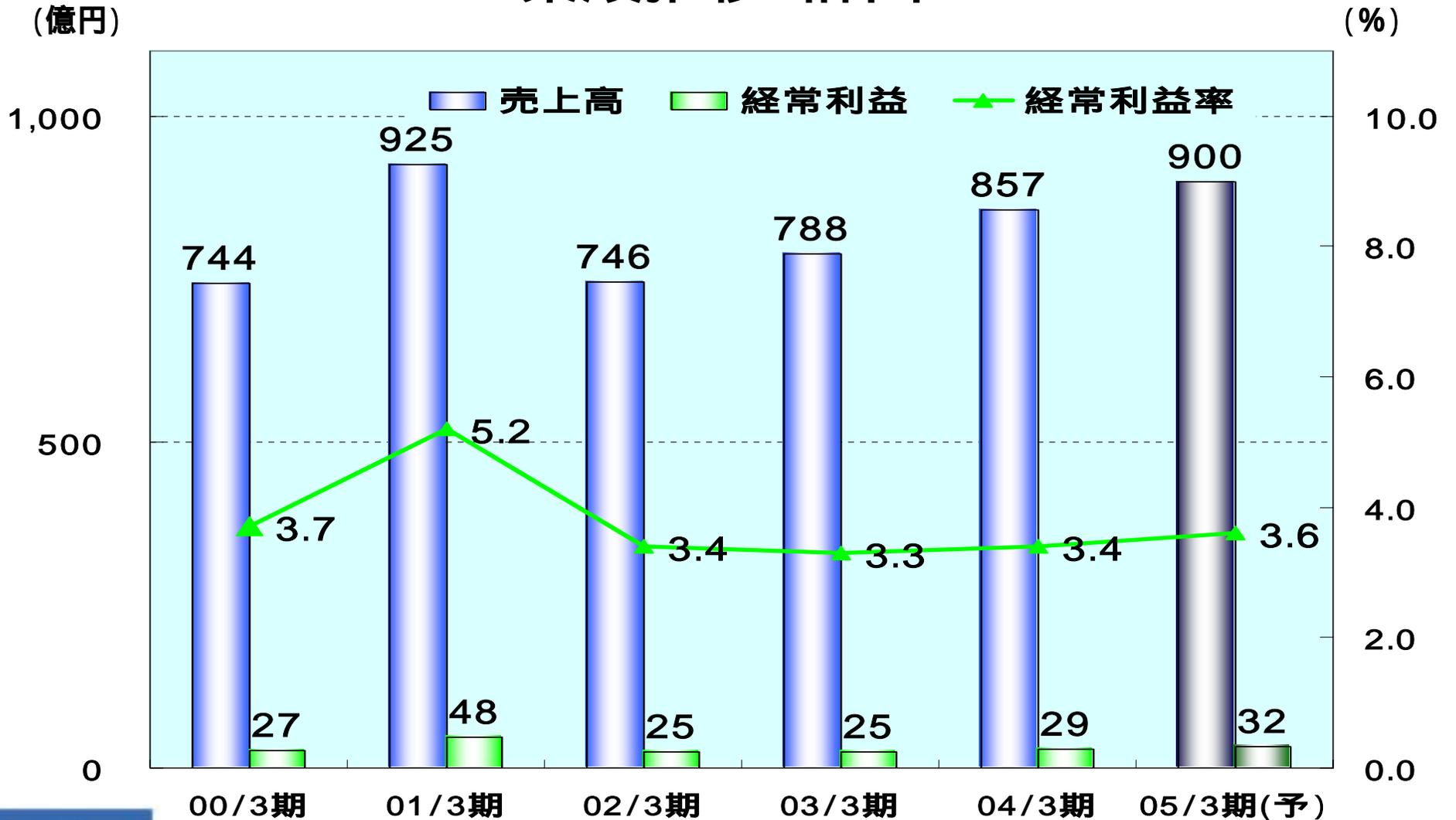
(単位:百万円)

	上期予想	下期予想	通期予想	対前年 増減率
売上高	44,000	46,000	90,000	5.0 %
経常利益	1,300	1,900	3,200	8.4 %
当期純利益	750	1,100	1,850	10.1 %
1株当たり配当金	5,000円	5,000円	10,000円	

1株当たり予想当期純利益(通期): 40,217.39円

予想 R O E : 13.7 %

業績推移・計画



中期の課題

- **マーケティング**
顧客要求の商品/ビジネスモデルへの対応
- **収益の確保**
安定した利益成長の実現
- **収益率の向上**
開発ビジネスの成長

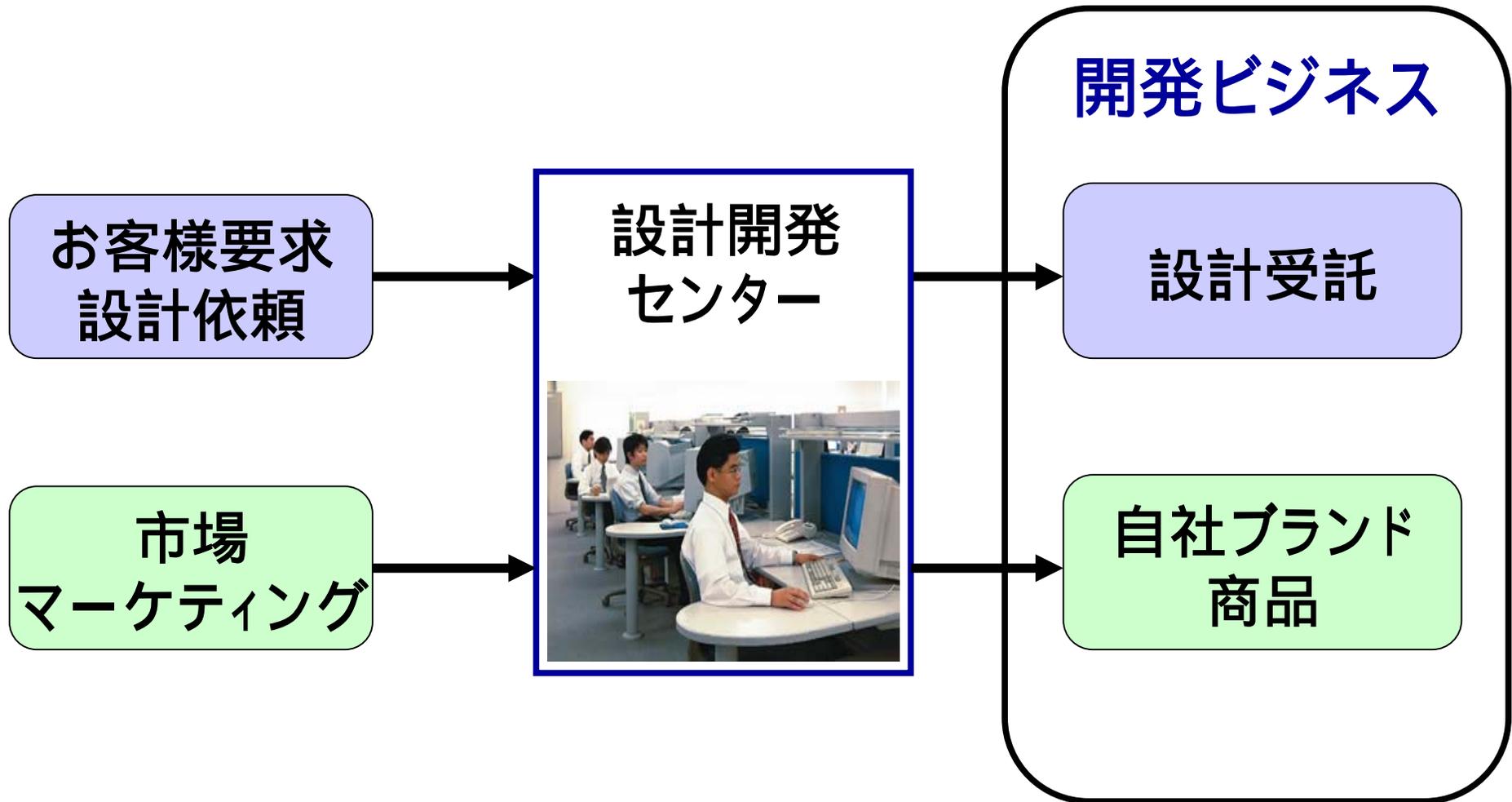
今期の活動方針

- 営業拠点の拡充
- 高付加価値商品の売上拡大
- 開発ビジネスの体制強化

開発ビジネスについて



高付加価値事業への取組み

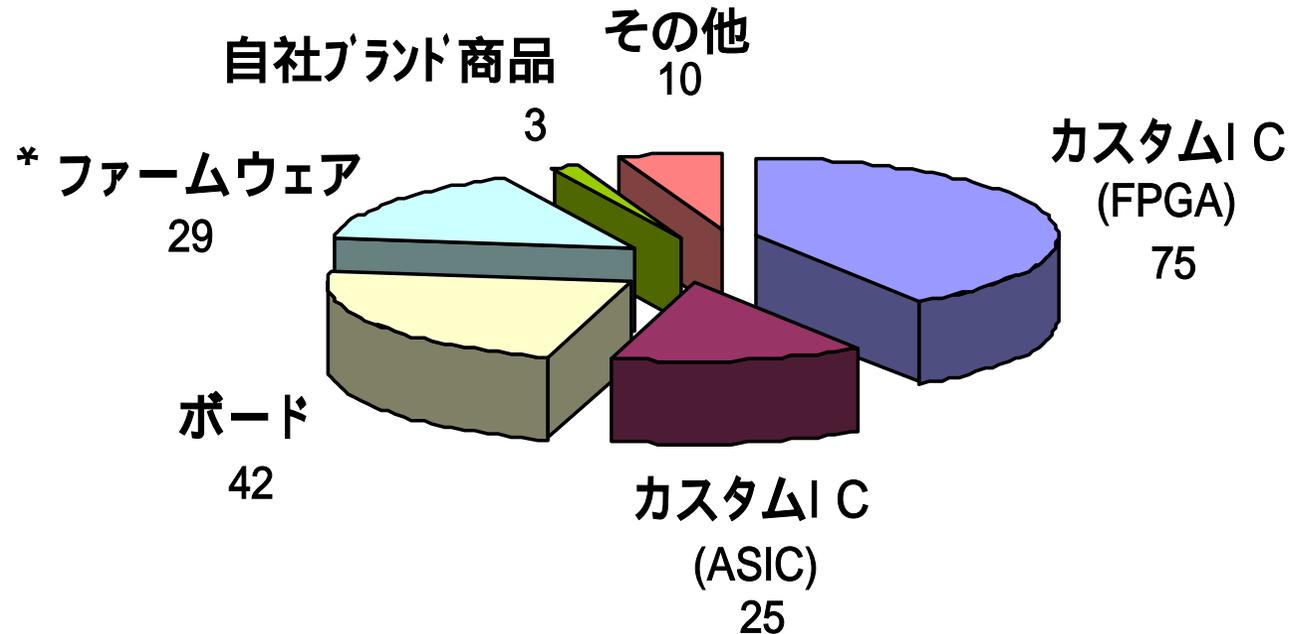


設計開発センター 開発件数

・件数:184件

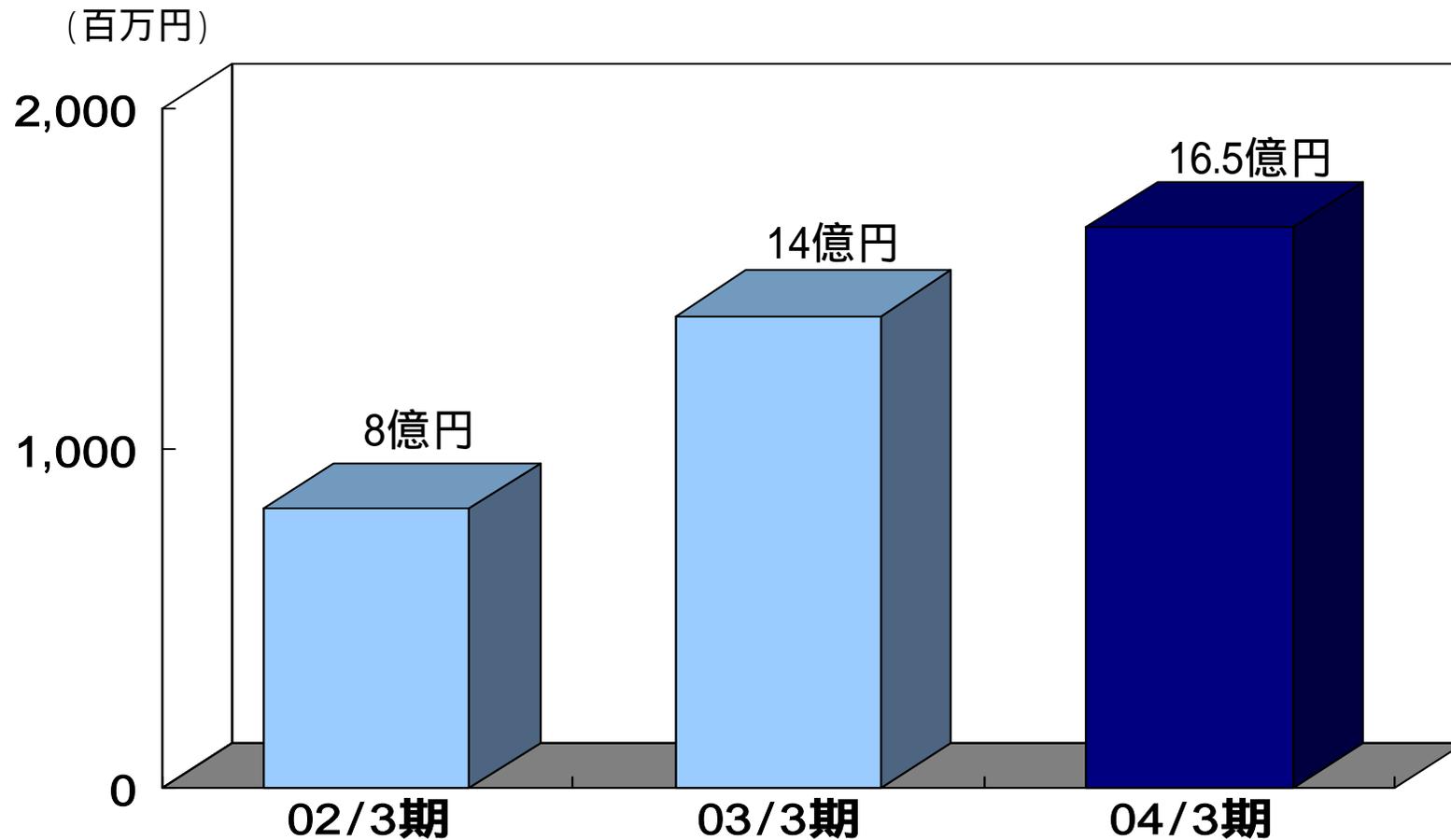
< 2004年3月期 内訳 >

(単位:件)



* ファームウェア:機器の中に組み込まれるソフトウェア

設計受託業務 受注額推移



取扱い商品との組み合わせ例

高精細デジタルディスプレイ用IC

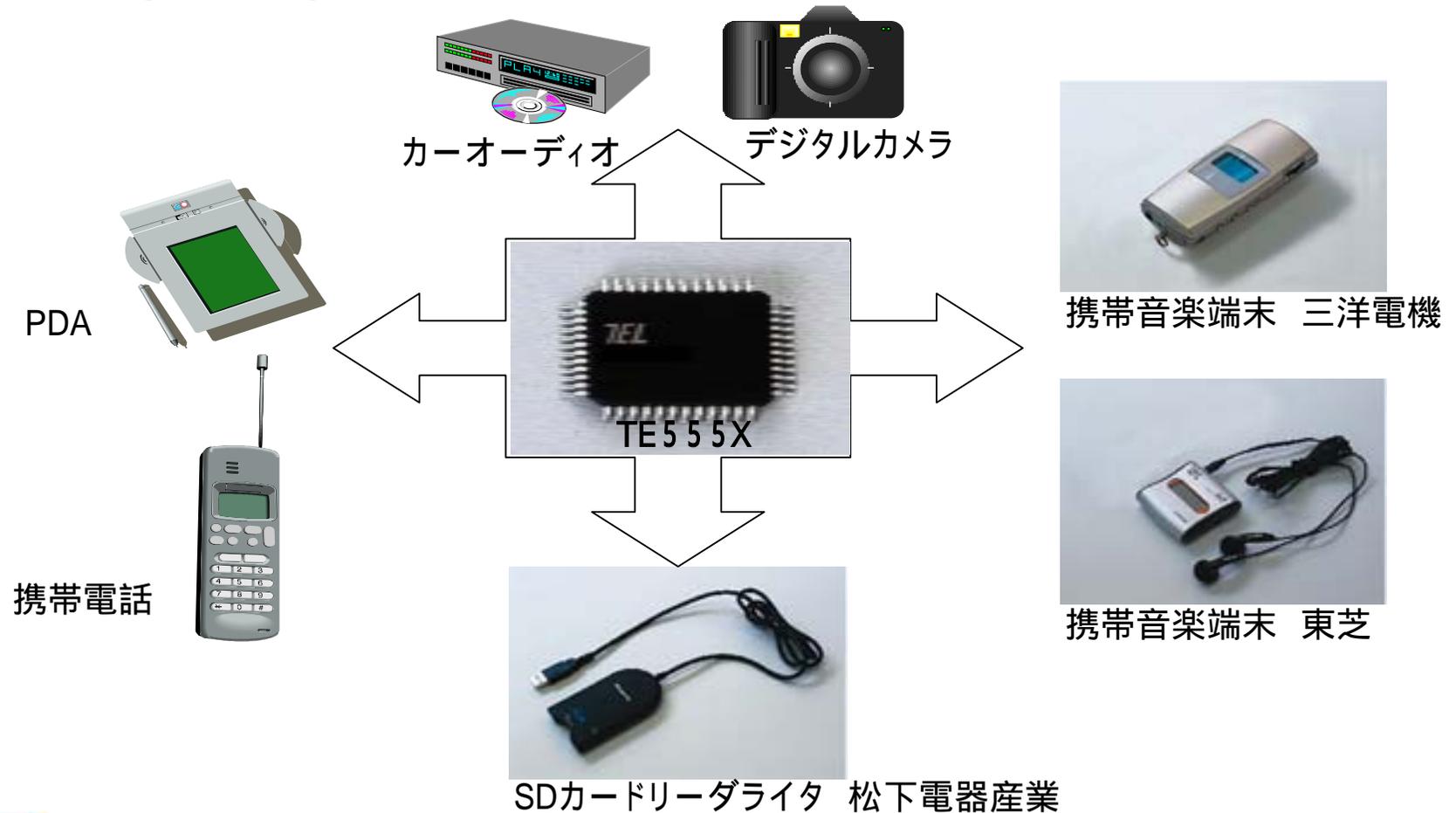
(ピクセルワークス社画像処理ICとの組み合わせ)



TE8200PF

保有技術活用例

メモリカード コントローラ



注)社名は、敬称を省略させていただいております。

産学連携例

超高速並列演算ボード

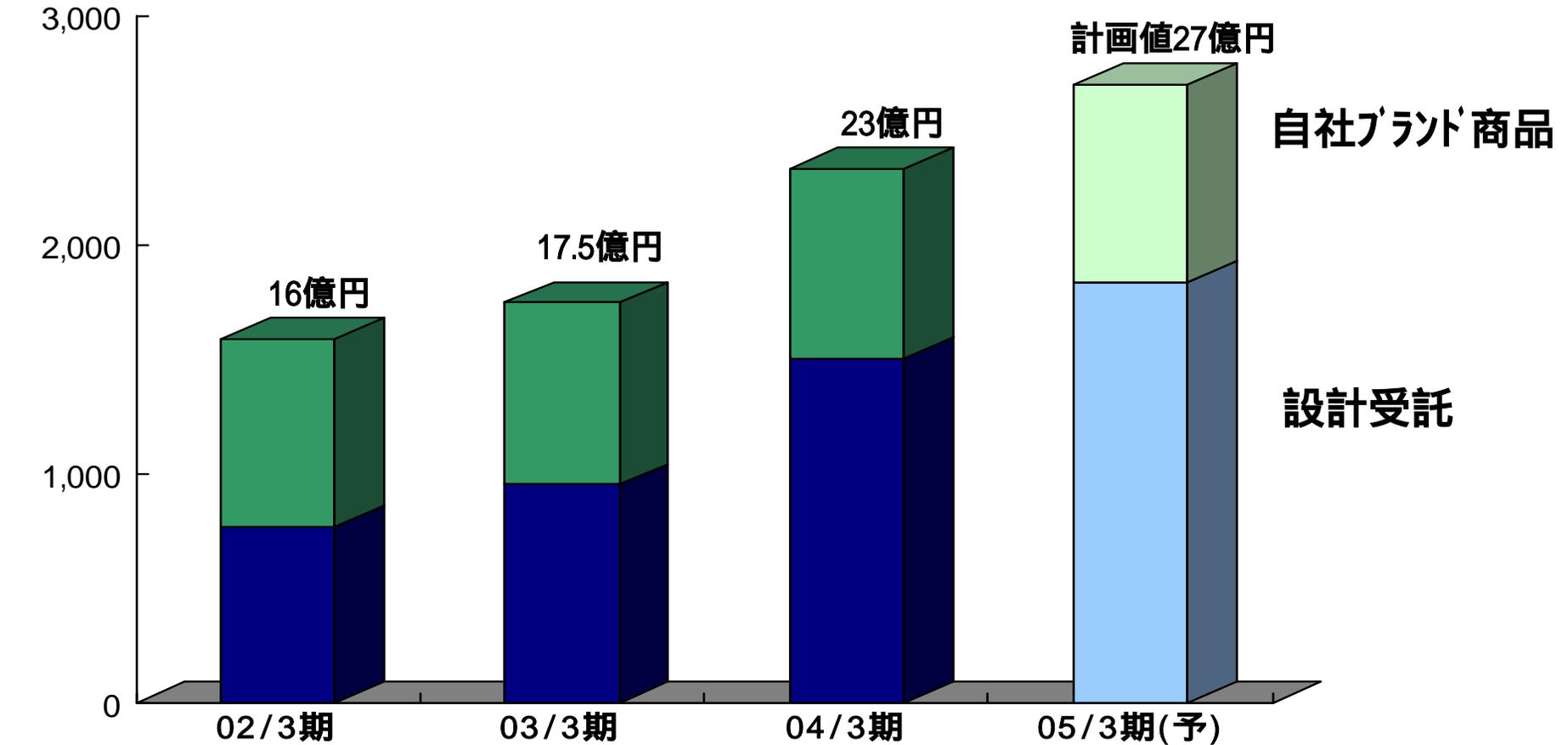
天体軌道シミュレーション、遺伝子解析等の超高速演算が
パソコンベースで可能



< 理化学研究所・千葉大学・当社の共同開発 >

開発ビジネス 売上高推移・計画

(百万円)



企業目標

No.1の技術商社

企業文化

権限委譲

正直、公平な行動

資料取扱い上の注意

このプレゼンテーションで述べられている将来の当社事業に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに構築されたものです。

当社の参画するエレクトロニクス業界は変化のスピードが大変速く、また、世界経済、半導体市況など、当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。

したがって、今後当社の業績見通しが本プレゼンテーションと異なる可能性があることをお含みおきください。また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。

用語説明(1)

半導体製品	主な取扱商品	機能
カスタムIC	ASIC(富士通株) PLD(サイリンクス社)	お客様の仕様に応じて作られる固有IC
専用IC	画像処理用IC 通信用・ネットワーク用IC	特定用途用に作られた専用IC
汎用IC	汎用リニアIC(アナログIC) 汎用ロジックIC	色々な用途に共通に使用されるIC
メモリーIC	DRAM、SRAM フラッシュメモリ	記憶用IC、書込み、読出しが可能なものや 読出しのみのものがある
CPU	マイクロプロセッサ、DSP	演算機能、電子機器の頭脳
光学部品	発光ダイオード、フォトカプラ	電気を光に変換して使用するIC
個別素子	整流素子、トランジスタ	増幅、整流などの機能を持つ部品

用語説明(2)

ボード製品		プリント配線基板の上にIC、電源、コネクタなどの部品を実装した製品
ソフトウェア		マイクロソフト社の産業機器に組み込まれるOSを中心に販売(PC用以外)
一般電子部品		機器間を接続するコネクタやケーブル、液晶表示部品、電源など、電子機器には不可欠な周辺部品